

半導体用ウエットエッチング剤 バッファードフッ酸 BHF シリーズ

TECHNICAL DATASHEET

ウエットエッチング剤 バッファードフッ酸 BHF シリーズは、フッ化水素酸とフッ 化アンモニウムの混合品です。

概要

- 半導体製造向けに金属イオン等の不純物を大幅に低減した高品質なエッチング剤です。
- フッ化水素酸とフッ化アンモニウムの混合比率により、エッチングレートや選択比のコントロールが 可能です。

一般物性

項目	単位	数値
HF 濃度	mass%	混合比による
NH4F 濃度	mass%	混合比による

【検査項目】

- アニオン系物質、金属イオン、微粒子
- 個別の品質につきましては、お問い合わせ下さい。

取扱方法/安全情報

- ご使用前にSDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するもの ではありません。医療用途、食品用途などにお使いの場合は、当社まで事前にご連絡下さい。

梱包仕様

- 5Kg、20Kg、100Kg、1000kg

For more information, visit our website.

タイキン工業株式会社

https://www.daikinchemicals.com/jp

tds-bhf-J_ver01_Aug_2019 Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019